

二零二五年第十届集成电路与微系统国际会议

2025年10月17-19日 | 中国合肥

<http://icim.net/>

ICIM 2025

二零二五年第十届集成电路与微系统国际会议将于2025年10月17-19日在中国合肥举行!ICIM2025将由安徽大学,东南大学,电子科技大学联合主办,安徽大学承办。

特邀报告嘉宾招募

- ICIM2025面向国内外的集成电路与微系统领域专家、学者征集演讲嘉宾。
- ICIM2025将遴选优秀报告分配到相关论坛,请报名者将履历背景及学术成果、演讲题目及摘要、两寸本人照片以附件形式发送至会议邮箱(icim_conf@vip.163.com)。
- 演讲嘉宾须以分享最佳实践及研究成果为主,不得在演讲过程中进行任何产品和服务宣传。
- 会议完全根据评选情况择优选用,根据日程安排分配对应论坛。评选结果将于三个工作日内邮件通知所提交材料报名者。

征稿主题

(包括但不限于以下)

■ Track 1: 电子设计自动化(EDA)

EDA算法的进展
适用于新兴技术的EDA
与EDA的硬件-软件协同设计
高性能计算(HPC)中的EDA
模拟和混合信号设计中的EDA

■ Track 2: 集成电路和系统设计

数字、模拟、混合信号IC和SOC设计技术
IC计算机辅助设计技术、DFM
建模和仿真

■ Track 3: 半导体器件和电路

无线系统的器件和电路
低功耗、射频器件和电路
硅/锗器件和器件物理
复合半导体器件和电路

■ Track 4: 工艺技术和制造

硅集成电路和制造
互连、低K、高K和其他工艺技术
封装和测试技术、设备技术

更多主题信息请查看官网: <http://icim.net/call-for-papers.html>

主题分会征集

本次会议面向所有学者征集Track(主题分会),如您愿意组织一个或多个track,请联系会议助理获取详细信息。所有track文章同样收录会议论文集,并提交EI核心,Scopus检索。track组织者也会得到会务组相应的赞助支持。

投稿指南

1. 全文投稿(作大会报告&出版)

2. 摘要投稿(仅作大会报告)

线上投稿系统: <https://easychair.org/conferences/?conf=icim2025>

邮箱投稿: icim_conf@vip.163.com

全文模板下载(Word): <http://icim.net/files/Template.doc>

全文模板下载(Latex): <http://icim.net/files/IEEE-conference-proceeding-Latex.rar>

会议出版

投稿的文章将通过同行评审,录用后将出版到会议论文集,收录于数据库,并被EI核心,Scopus等著名数据库检索。

**ICIM2016-2024均被收录于IEEE数据库并成功被EI核心以及Scopus检索。

会议历史

ICIM2016	成都	IEEE	ISBN: 978-1-5090-2814-6
ICIM2017	南京	IEEE	ISBN: 978-1-5386-3506-3
ICIM2018	上海	IEEE	ISBN: 978-1-5386-8311-8
ICIM2019	北京	IEEE	ISBN: 978-1-7281-5132-8
ICIM2020	南京	IEEE	ISBN: 978-1-7281-8978-9
ICIM2021	南京	IEEE	ISBN: 978-1-6654-5886-3
ICIM2022	西安	IEEE	ISBN: 978-1-6654-6042-2
ICIM2023	南京	IEEE	ISBN: 979-8-3503-1849-4
ICIM2024	武汉	IEEE	ISBN: 979-8-3315-0944-6

重要日期

投稿截止

录用通知

注册截止

2025年7月15日

2025年8月10日

2025年8月25日

主办单位

承办单位

赞助单位



媒体支持



组委会

■ 名誉主席

毛军发, 深圳大学, 中国, 院士 (IEEE FELLOW)
郝 跃, 西安电子科技大学, 中国, 院士 (IEEE Senior Member)
Ljiljana Trajkovic, 西门菲莎大学, 加拿大 (IEEE FELLOW)

■ 大会主席

王志功, 东南大学, 中国 (IEEE Senior Member)
吴秀龙, 安徽大学, 中国 (IEEE Senior Member)
马凯学, 天津大学, 中国 (IEEE FELLOW)

■ 大会联席主席

徐 宁, 武汉理工大学, 中国
温晓青, 九州工业大学, 日本 (IEEE FELLOW)
李 强, 电子科技大学, 中国

■ 程序委员会主席

Abdel-Hamid Ali Soliman, 斯泰福厦大学, 英国 (IEEE Member)
韩 军, 复旦大学, 中国
虞小鹏, 浙江大学, 中国
张 萌, 东南大学, 中国
常 胜, 武汉大学, 中国 (IEEE Senior Member)
陈莹梅, 东南大学, 中国
蔡志匡, 南京邮电大学
邹 卓, 复旦大学, 中国 (IEEE Senior Member)
胡建国, 中山大学, 中国
余 备, 香港中文大学, 中国

■ 程序委员会联席主席

邓军勇, 西安邮电大学
徐 骏, 南通大学/南京大学, 中国
邱志雄, 西南交通大学, 中国
罗国杰, 北京大学, 中国
翟晓君, 埃塞克斯大学, 英国
邢 炜, 谢菲尔德大学, 英国

■ 程序委员会委员

刘 波, 东南大学, 中国 (IEEE Member)
浦 实, 武汉理工大学, 中国
宋海智, 电子科技大学, 中国
朱 璐, 中山大学, 中国
张有明, 东南大学, 中国
唐建石, 清华大学, 中国 (IEEE Senior Member)
绳伟光, 上海交通大学, 中国
Hao Gao, 埃因霍温理工大学, 荷兰
Yun Fang, Silicon Austria Labs, 奥地利 (IEEE Member)
Jeff Kilby, 奥克兰理工大学, 新西兰
周智君, 东南大学, 中国
佟星元, 西安邮电大学, 中国
胡 伟, 西北工业大学, 中国
毕朝日, 复旦大学, 中国
黄正峰, 合肥工业大学, 中国

■ 本地主席

程 林, 中国科技大学, 中国

■ 出版主席

Zhao Xinyu, 浙江大学, 中国
Wu Qiang, 北京中科工能环境技术研究院

■ 学生程序委员会主席

孙宏斌, 西安交通大学, 中国 (IEEE Member)
王科平, 天津大学, 中国 (IEEE Senior Member)
尚德龙, 中国科学院, 中国
孟凡易, 天津大学, 中国 (IEEE Senior Member)

全部组委会成员信息, 请浏览网站: <https://icim.net/committee.html>

会议地点



文典阁(安徽大学磬苑校区)



会议秘书: 肖老师



会议邮箱: icim_conf@vip.163.com



电话: (86)134-0855-5552

联系我们